



# 平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成22年11月4日

上場会社名 住友ベークライト株式会社

上場取引所 東大

コード番号 4203 URL <http://www.sumibe.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 林 茂

問合せ先責任者 (役職名) 経理企画本部副本部長

(氏名) 寺島 郁朗

TEL 03-5462-3452

四半期報告書提出予定日 平成22年11月10日

配当支払開始予定日

平成22年12月3日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (証券アナリスト、機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成23年3月期第2四半期の連結業績(平成22年4月1日～平成22年9月30日)

### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年3月期第2四半期	97,908	24.1	6,233	—	7,006	—	3,670	—
22年3月期第2四半期	78,922	△34.2	160	△96.9	570	△91.2	△2,193	—

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
23年3月期第2四半期	15.23	—
22年3月期第2四半期	△9.10	—

### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
23年3月期第2四半期	202,864	126,042	61.6	518.30
22年3月期	207,258	128,573	61.5	528.96

(参考) 自己資本 23年3月期第2四半期 124,882百万円 22年3月期 127,453百万円

## 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
22年3月期	—	5.00	—	5.00	10.00
23年3月期	—	7.50	—	—	—
23年3月期(予想)	—	—	—	7.50	15.00

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 無

## 3. 平成23年3月期の連結業績予想(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	190,000	11.2	12,000	59.1	13,000	50.4	8,000	142.0	33.20

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 無

4. その他（詳細は、【添付資料】5ページ「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 無

(注)当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 有

(注)簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

(注)「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年3月期2Q 262,952,394株 22年3月期 262,952,394株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q 22,007,029株 22年3月期 22,002,232株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年3月期2Q 240,948,031株 22年3月期2Q 240,963,166株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件等については、【添付資料】4ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

## ○添付資料の目次

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	3
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	4
2. その他の情報	5
(1) 重要な子会社の異動の概要	5
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要	5
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要	5
3. 四半期連結財務諸表	6
(1) 四半期連結貸借対照表	6
(2) 四半期連結損益計算書	8
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(4) 継続企業の前提に関する注記	10
(5) セグメント情報	10
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	12

## 1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

## (1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間の世界経済は、欧州の財政・信用不安や米国の減速が懸念されるなか、中国・インドなどの新興国の成長に牽引され回復基調で推移しましたが、足元では減速の兆しが見えつつあります。

日本経済も、海外の景気改善に支えられ輸出と生産が増加し、設備投資も持ち直しの動きが見られるなど緩やかに回復が進みましたが、このところ輸出と生産に停滞が見られ、円高の進行や株価の低迷が続くなど先行き不透明な状況が続いております。

当社グループを取り巻くグローバルな経営環境は、半導体については、前半はデジタル家電やパソコンの増加など市場全体の復調に加えて、スマートフォンやタブレット型端末の需要も加わり、回復が進みましたが、後半に入るとスマートフォンなどは引き続き好調なものの市場全体ではやや弱含みの傾向がみられるようになりました。自動車は、前期から各国が行ったエコカー減税などの景気刺激策に支えられたことや、中国などの新興国の需要が増加したことで回復が進みましたが、今後、景気刺激策終了の影響が懸念されています。

一方、国内環境につきましては、携帯電話は携帯情報端末の販売が増加したものの低い水準が続き、住宅着工件数も持ち直しの動きがみえてきましたが依然として低調な状況が続きました。

当社グループは、このような経営環境の中で、前期までの緊急経営対策によってスリム化したコスト構造を維持しながら、次の方針を掲げ、新たな需要の創造に取組み成長軌道への復帰を目指してきました。

- ① 「情報通信材料」「高機能プラスチック」「クオリティオブライフ」3コア事業の競争力強化
- ② 顧客ニーズを先取りした次世代ソリューションの提供
- ③ 「モノづくり」競争力の向上
- ④ B to Bビジネススタイルを重視した「CS活動」「マーケティング活動」の促進

この結果、当第2四半期連結累計期間の経営成績につきましては、連結売上高は高機能プラスチック製品や半導体関連材料を中心に大幅に増加し、前年同期比で24.1%増加し97,908百万円となりました。利益につきましては、原料価格の上昇や円高の進行など悪化要因がありましたが、売上高の大幅な増加と、前期に実施した不採算事業の構造改革などによる固定費の抑制効果により、連結営業利益は前年同期比6,073百万円増加し6,233百万円、連結経常利益は6,436百万円増加し7,006百万円、連結四半期純利益は5,863百万円増加し3,670百万円となりました。

## 事業の分野別販売状況(対前年同期比較)

## ① 「半導体関連材料」部門

半導体封止用エポキシ樹脂成形材料、感光性ウエハーコート用樹脂、半導体実装用キャリアテープは、前半は半導体市場全体の回復やスマートフォンなどの新分野での需要拡大から売上高は大幅に増加しましたが、後半は半導体市場に需要減少の兆しが見られ、売上高はやや伸び悩みました。

半導体基板材料「LαZ」は、スマートフォンを含む各種携帯機器での採用が順次進んでいます。

## ② 「回路製品」部門

エポキシ樹脂銅張積層板・フェノール樹脂銅張積層板は、車載やデジタル家電用途等の需要の増加から、売上高は増加しました。

フレキシブル・プリント回路は、一部の不採算分野からの撤退などにより、売上高は減少しました。なお、ベトナムへの生産の完全集約は予定どおり本年6月で完了し、秋田の研究開発拠点についても宇都宮に集約をはかることを決定しました。

## ③ 「高機能プラスチック」部門

フェノール樹脂成形材料、工業用フェノール樹脂および成形品は、中国・インドなどの新興国や北米を中心とする各国の自動車市場の回復と欧州の住宅用断熱材の伸張から、売上高は大幅に増加しました。また、北米ではこの市況の回復と、前期から実施している生産拠点の統廃合などの構造改革から急速に業績が回復しました。

なお、工業用フェノール樹脂の生産販売会社として江蘇省南通市に設立した「南通住友電木有限公司」に中国市場の需要拡大への対応を図るべくフェノール樹脂成形材料工場を新設追加することを決定しました。

④「クオリティオブライフ関連製品」部門

医療機器製品は、胃瘻用ボタンおよび胃瘻造設キットについてはラインナップを増やし販売の拡大を図るなど、売上高は順調に増加しました。

ビニル樹脂シートおよび複合シートは、医薬品包装用途が増加したことやエレクトロニクス用途の需要回復により、売上高は堅調に推移しました。

ポリカーボネート樹脂板、塩化ビニル樹脂板、メラミン樹脂化粧板・不燃板などのプレート・デコラ事業は、需要の回復から売上高は増加しました。また、前期から実施した事業の構造改革と費用削減策を推進したことで業績は大幅に改善しました。

防水関連事業は、リフォーム分野が堅調に推移し、新築分野の需要が増加したことで売上高は増加しました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(2.1) 資産、負債および純資産の状況

①資産の部

総資産は、前連結会計年度末に比べ43億94百万円減少し、2,028億64百万円となりました。

これは主に、受取手形および売掛金が29億47百万円増加した一方で、コマーシャル・ペーパーの減額や配当金の支払などにより現金および預金が30億1百万円減少したこと、株式相場下落に伴う時価評価・減損等により投資有価証券が22億60百万円減少したことおよび在外子会社の換算レートが前連結会計年度末に比べ円高に進行したため資産の円換算額が減少したことによるものであります。

②負債の部

負債合計は、前連結会計年度末に比べ18億63百万円減少し、768億22百万円となりました。

これは主に、支払手形および買掛金が26億84百万円増加した一方で、コマーシャル・ペーパーを30億円減額するなど有利子負債を減少させたことによるものであります。

③純資産の部

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ25億31百万円減少し、1,260億42百万円となりました。

これは主に、四半期純利益を36億70百万円計上した一方で、為替換算調整勘定が38億20百万円減少したこと、その他有価証券評価差額金が12億38百万円減少したことおよび配当金の支払12億4百万円があったことによるものであります。

(2.2) キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間末の現金および現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ31億57百万円減少し、292億48百万円となりました。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動により得られた資金は74億62百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益、減価償却費の計上および仕入債務の増加による収入と、売上債権およびたな卸資産の増加による支出の結果であります。前年同期と比べると30億38百万円の収入の増加となりました。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動に用いた資金は48億67百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出の結果であります。前年同期と比べると13億37百万円の支出の増加となりました。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動に用いた資金は47億45百万円となりました。これは主に、コマーシャル・ペーパーの減額および配当金の支払による支出の結果であります。前年同期と比べると47億23百万円の支出の減少となりました。

## (3) 連結業績予想に関する定性的情報

当社グループを取り巻く事業環境につきましては、世界経済は中国・インドなどの新興国の成長が期待されているものの、欧州や米国の減速のリスクを抱え予断を許さない状況が続くものと思われまます。国内経済も、株価の低迷や雇用情勢の悪化が続いている中で、急速に円高が進行したこともあり、以前にもまして不透明な状況が続くものと思われまます。また、当社の業績に大きく影響する半導体や自動車市況については、各国の景気刺激策の終了などからやや弱含みの状態が続くと予想しております。このような状況のなかで、身の丈経営により筋肉質となった企業体質を維持するとともに、顧客ニーズを先取りし需要を掘り起こし、営業・マーケティング・工場が一体となり販売の拡大を図り、業績の維持・向上に努めてまいります。

## 第3および第4四半期の経済環境見通し(第1および第2四半期比較)

半導体生産額(世界)	若干の減少
自動車生産台数(世界)	若干の減少
携帯電話生産台数(世界)	横ばい
パソコン販売台数(世界)	若干の減少
住宅着工戸数(日本)	若干の増加 700~800千戸/年
対円・米ドルレート	80円/US\$ (第3および第4四半期)

平成23年3月通期の業績見通しにつきましては、上述の前提のもと、平成22年5月7日に公表いたしました連結売上高1,900億円、連結営業利益120億円、連結経常利益130億円、連結当期純利益80億円から変更しておりません。

## 2. その他の情報

### (1) 重要な子会社の異動の概要

該当事項はありません。

### (2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

法人税等ならびに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法

当社および一部の連結子会社は、法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっております。

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

### (3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

#### ①「持分法に関する会計基準」および「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

第1四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年3月10日公表分）および「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年3月10日）を適用しております。

これによる損益への影響はありません。

#### ②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。

これによる当第2四半期連結累計期間の営業利益および経常利益への影響は軽微であり、税金等調整前四半期純利益は79百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は155百万円であります。

#### ③表示方法の変更

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年3月24日 内閣府令第5号）の適用により、当第2四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

## 3. 四半期連結財務諸表

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成22年9月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	29,956	32,957
受取手形及び売掛金	44,802	41,855
商品及び製品	8,003	7,870
半製品	2,496	2,151
仕掛品	784	790
原材料及び貯蔵品	8,737	8,165
その他	5,933	5,198
貸倒引当金	△283	△403
流動資産合計	100,429	98,587
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	31,198	32,623
機械装置及び運搬具(純額)	25,273	27,796
その他(純額)	18,796	18,282
有形固定資産合計	75,268	78,702
無形固定資産		
のれん	5,488	5,975
その他	1,173	1,385
無形固定資産合計	6,662	7,361
投資その他の資産	20,504	22,607
固定資産合計	102,435	108,671
資産合計	202,864	207,258



(単位：百万円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成22年9月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	30,861	28,177
短期借入金	6,888	7,108
コマーシャル・ペーパー	—	3,000
未払法人税等	1,133	926
賞与引当金	2,740	2,325
その他	10,974	11,186
流動負債合計	52,597	52,725
固定負債		
長期借入金	11,951	12,401
退職給付引当金	7,342	8,232
事業再建費用引当金	696	1,103
その他の引当金	371	312
負ののれん	1,200	1,611
その他	2,662	2,299
固定負債合計	24,224	25,960
負債合計	76,822	78,685
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	37,143	37,143
資本剰余金	35,358	35,358
利益剰余金	78,334	75,845
自己株式	△11,917	△11,915
株主資本合計	138,917	136,431
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	868	2,106
為替換算調整勘定	△14,904	△11,084
評価・換算差額等合計	△14,035	△8,977
少数株主持分	1,160	1,120
純資産合計	126,042	128,573
負債純資産合計	202,864	207,258

(2) 四半期連結損益計算書  
【第2四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)
売上高	78,922	97,908
売上原価	57,754	69,827
売上総利益	21,168	28,080
販売費及び一般管理費	21,008	21,847
営業利益	160	6,233
営業外収益		
受取利息	68	48
受取配当金	129	302
負ののれん償却額	416	410
持分法による投資利益	102	89
為替差益	—	165
雑収入	225	169
営業外収益合計	942	1,186
営業外費用		
支払利息	197	171
為替差損	94	—
雑損失	240	242
営業外費用合計	531	414
経常利益	570	7,006
特別利益		
固定資産売却益	18	221
投資有価証券売却益	0	—
関係会社株式売却益	197	—
その他	—	4
特別利益合計	216	225
特別損失		
固定資産除売却損	307	355
投資有価証券評価損	873	206
事業再建関連費用	1,940	331
減損損失	122	419
解決金等	528	236
環境対策引当金繰入額	—	73
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	79
事業整理損	28	—
その他	1	30
特別損失合計	3,802	1,732
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△3,014	5,498
法人税、住民税及び事業税	589	1,074
法人税等調整額	△1,445	661
法人税等合計	△855	1,735
少数株主損益調整前四半期純利益	—	3,762
少数株主利益	34	92
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△2,193	3,670

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△3,014	5,498
減価償却費	5,879	5,392
減損損失	122	419
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△203	△574
固定資産除売却損益(△は益)	288	133
受取利息及び受取配当金	△197	△351
支払利息	197	171
投資有価証券評価損益(△は益)	873	206
関係会社株式売却損益(△は益)	△197	—
売上債権の増減額(△は増加)	△3,176	△3,884
たな卸資産の増減額(△は増加)	4,366	△1,779
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△1,239	△493
仕入債務の増減額(△は減少)	1,178	3,197
その他の流動負債の増減額(△は減少)	△836	691
その他	315	△599
小計	4,356	8,029
利息及び配当金の受取額	202	358
利息の支払額	△198	△235
法人税等の支払額	64	△690
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,424	7,462
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△4,522	△4,580
有形固定資産の売却による収入	377	228
投資有価証券の取得による支出	△6	—
長期貸付けによる支出	△279	△75
その他	900	△439
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,530	△4,867
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△700	△82
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	△6,500	△3,000
配当金の支払額	△1,807	△1,204
少数株主への配当金の支払額	△1	—
自己株式の取得による支出	△5	—
その他	△452	△458
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,468	△4,745
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,272	△1,007
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△7,301	△3,157
現金及び現金同等物の期首残高	38,981	32,405
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△495	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	31,184	29,248

## (4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

## (5) セグメント情報

## 【事業の種類別セグメント情報】

前第2四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)

(単位：百万円)

	半導体・ 表示体材 料	回路製品	高機能 プラス チック	クオリテ ィオブラ イフ関連 製品	その他	計	消去又は 全社	連結
売上高								
(1) 外部顧客に 対する売上高	19,594	8,371	22,694	27,970	290	78,922	—	78,922
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	135	224	—	360	(360)	—
計	19,594	8,371	22,829	28,195	290	79,282	(360)	78,922
営業利益又は 営業損失(△)	2,120	△1,366	648	770	△26	2,146	(1,986)	160

(注) 1 事業区分は、製品の市場における主要用途、事業の類似性を勘案して区分しております。

2 各事業の主要な製品および役務の内容

(1) 半導体・表示体材料

半導体封止用エポキシ樹脂成形材料、感光性ウエハコート用液状樹脂、半導体用液状樹脂、半導体実装用キャリアテープ、半導体チップ接着用テープ

(2) 回路製品

フレキシブル・プリント回路、フェノール樹脂銅張積層板、エポキシ樹脂銅張積層板

(3) 高機能プラスチック

フェノール樹脂成形材料、工業用フェノール樹脂、精密成形品

(4) クオリティオブライフ関連製品

医療機器製品、メラミン樹脂化粧板・不燃板、ビニル樹脂シートおよび複合シート、鮮度保持フィルム、ポリカーボネート樹脂板、塩化ビニル樹脂板、水処理関連製品、防水工事の設計ならびに施工請負

(5) その他

試験研究の受託、土地の賃貸等

## 【所在地別セグメント情報】

前第2四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)

(単位：百万円)

	日本	アジア	北米	欧州その他 の地域	計	消去又は 全社	連結
売上高							
(1) 外部顧客に 対する売上高	50,552	17,985	4,865	5,519	78,922	—	78,922
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	5,022	3,342	117	8	8,490	(8,490)	—
計	55,575	21,327	4,982	5,527	87,413	(8,490)	78,922
営業利益又は 営業損失(△)	1,546	970	△346	△141	2,029	(1,869)	160

(注) 1 国又は地域の区分は、概ね地理的近接度によっております。

2 各区分に属する主な国又は地域

(1) アジア……シンガポール、マレーシア、中国、インドネシア、フィリピン、台湾、ベトナム、タイ

(2) 北米……米国、カナダ、メキシコ

(3) 欧州その他の地域……ベルギー、スペイン

## 【海外売上高】

前第2四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)

(単位:百万円)

	アジア	北米	欧州その他の地域	合計
I 海外売上高	25,361	4,798	5,447	35,607
II 連結売上高				78,922
III 海外売上高の連結売上高に占める割合	32.1%	6.1%	6.9%	45.1%

(注) 1 国又は地域の区分は、概ね地理的近接度によっております。

2 各区分に属する主な国又は地域

(1) アジア……シンガポール、マレーシア、中国、インドネシア、フィリピン、台湾、韓国、タイ

(2) 北米……米国、カナダ、メキシコ

(3) 欧州その他の地域……ベルギー、スペイン

3 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

## 【セグメント情報】

(追加情報)

第1四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年3月27日)および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日)を適用しております。

## 1 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、製品の市場における主要用途および事業の類似性を勘案し、「半導体関連材料」、「回路製品」、「高機能プラスチック」および「クオリティオブライフ関連製品」の4つを報告セグメントとしております。

各報告セグメントの主要な製品および役務の内容は以下のとおりであります。

## 「半導体関連材料」

半導体封止用エポキシ樹脂成形材料、感光性ウェハーコート用液状樹脂、半導体用液状樹脂、半導体実装用キャリアテープ、半導体チップ接着用テープ、半導体基板材料

## 「回路製品」

フレキシブル・プリント回路、フェノール樹脂銅張積層板、エポキシ樹脂銅張積層板

## 「高機能プラスチック」

フェノール樹脂成形材料、工業用フェノール樹脂、精密成形品、合成樹脂接着剤

## 「クオリティオブライフ関連製品」

医療機器製品、メラミン樹脂化粧板・不燃板、ビニル樹脂シートおよび複合シート、鮮度保持フィルム、ポリカーボネート樹脂板、塩化ビニル樹脂板、防水工事の設計ならびに施工請負、バイオ製品

## 2 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第2四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント					その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結損益計算書計上額 (注) 3
	半導体 関連材料	回路製品	高機能 プラス チック	クオリテ ィオブ ライフ 関連 製品	計				
売上高									
外部顧客への売上高	27,436	10,337	30,575	29,207	97,556	352	97,908	—	97,908
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	201	128	330	—	330	△330	—
計	27,436	10,337	30,777	29,336	97,887	352	98,239	△330	97,908
セグメント利益又は 損失(△)	3,983	△883	3,427	1,429	7,957	24	7,981	△1,748	6,233

(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、試験研究の受託、土地の賃貸等を含んでおります。

2 「セグメント利益又は損失(△)」の調整額△1,748百万円には、セグメント間取引消去15百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,763百万円が含まれております。全社費用の主なもの、基礎研究および当社の一般管理部門にかかる費用の一部であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

## (6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。